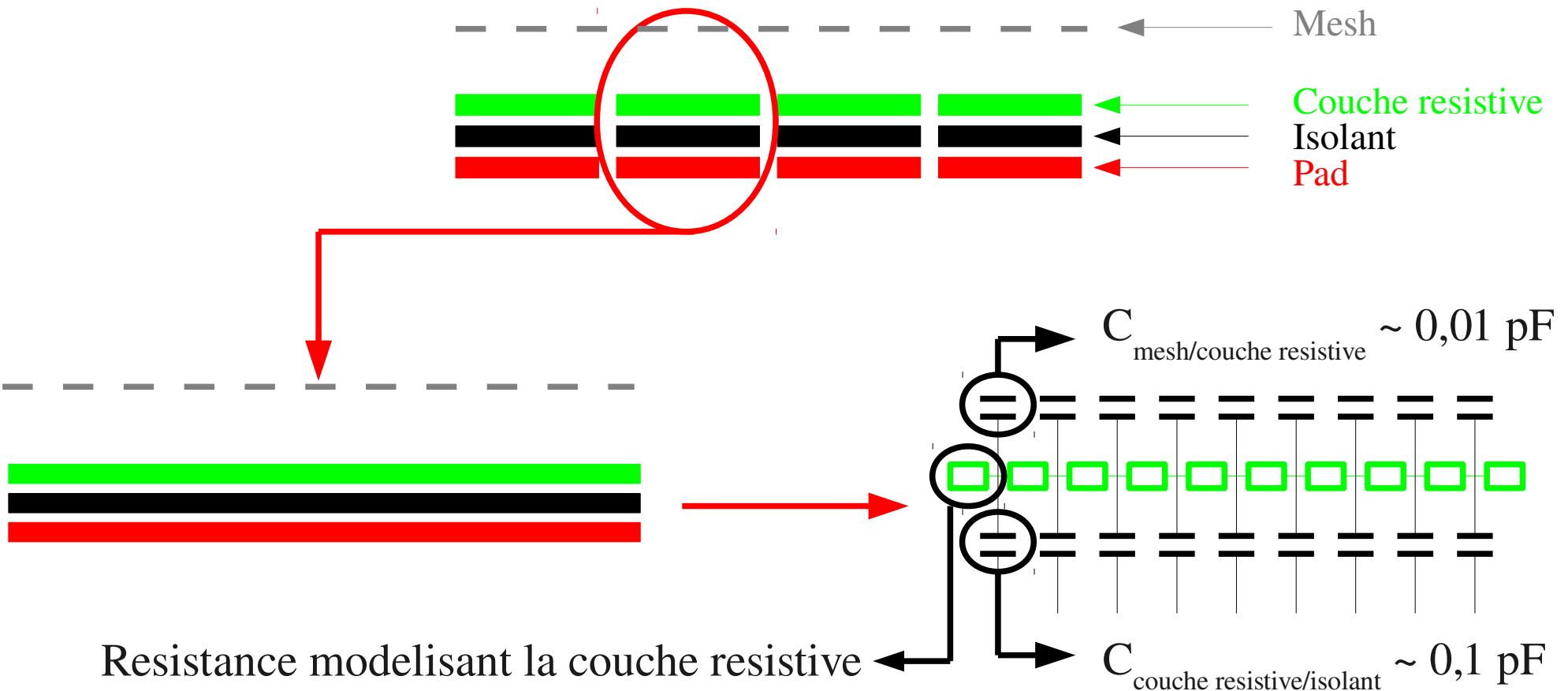


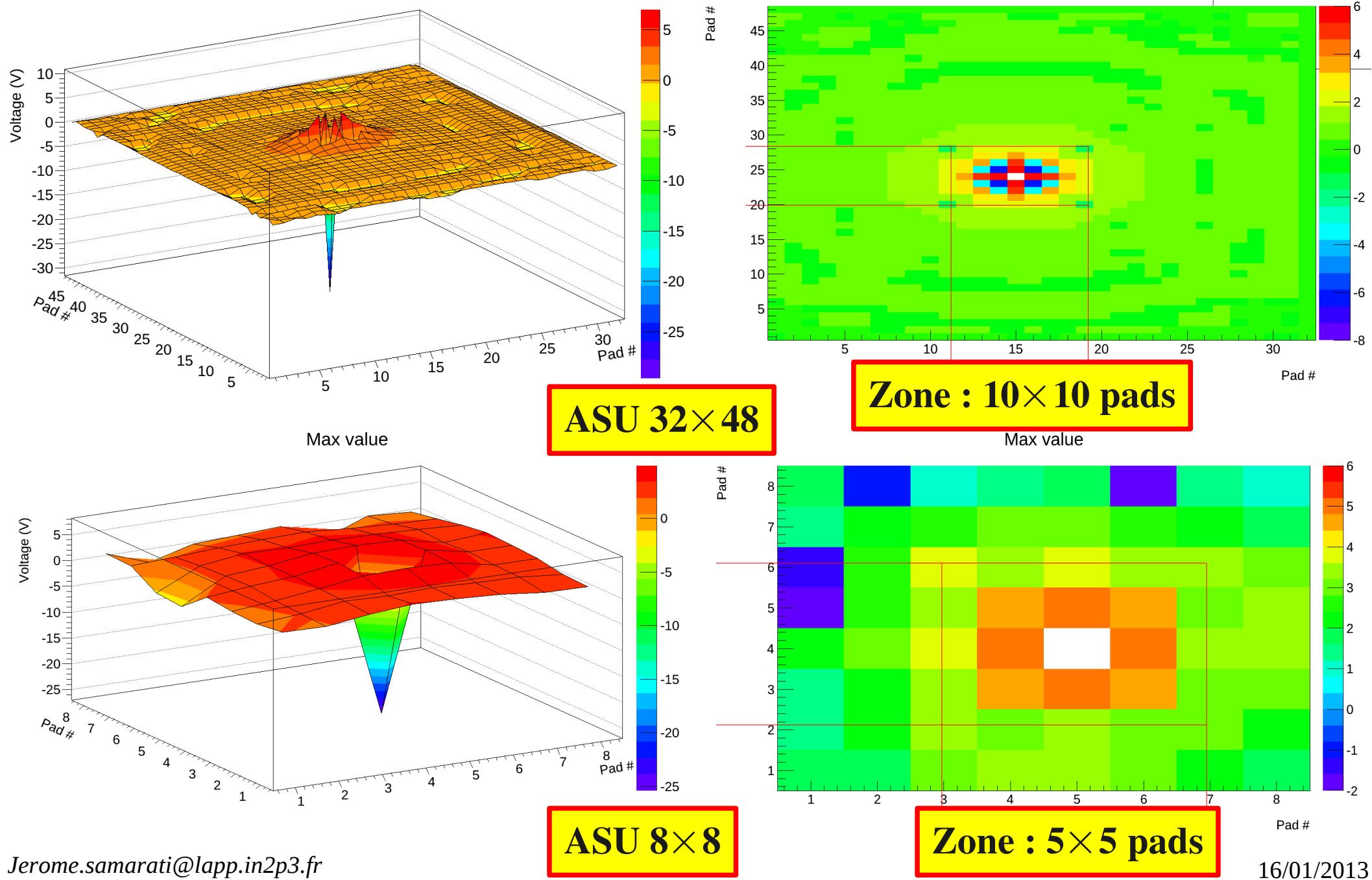
# Reunion technique : Prototypes micromegas resistifs

# Prototypes micromegas resistifs

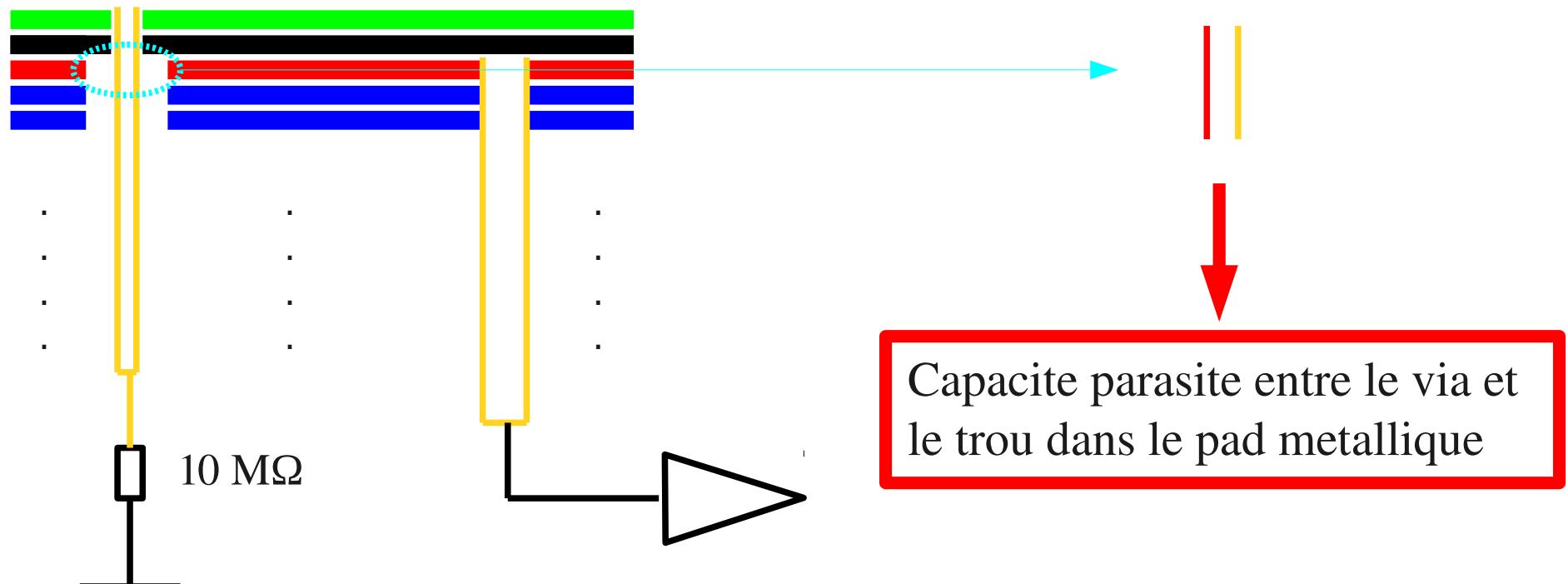


Les simulations ne montrent pas de differences entre un proto  $8 \times 8$  et un ASU  $32 \times 48$  en terme de "violences" de decharges → la couche resistive segmente le pad et maintient donc l'effet localement  
⇒ intérêt de faire un petit proto pour débuter (coût, temps de fabrication)

# Prototypes micromegas resistifs



# Idees de fabrication de prototypes micromegas resistifs (solution #1)

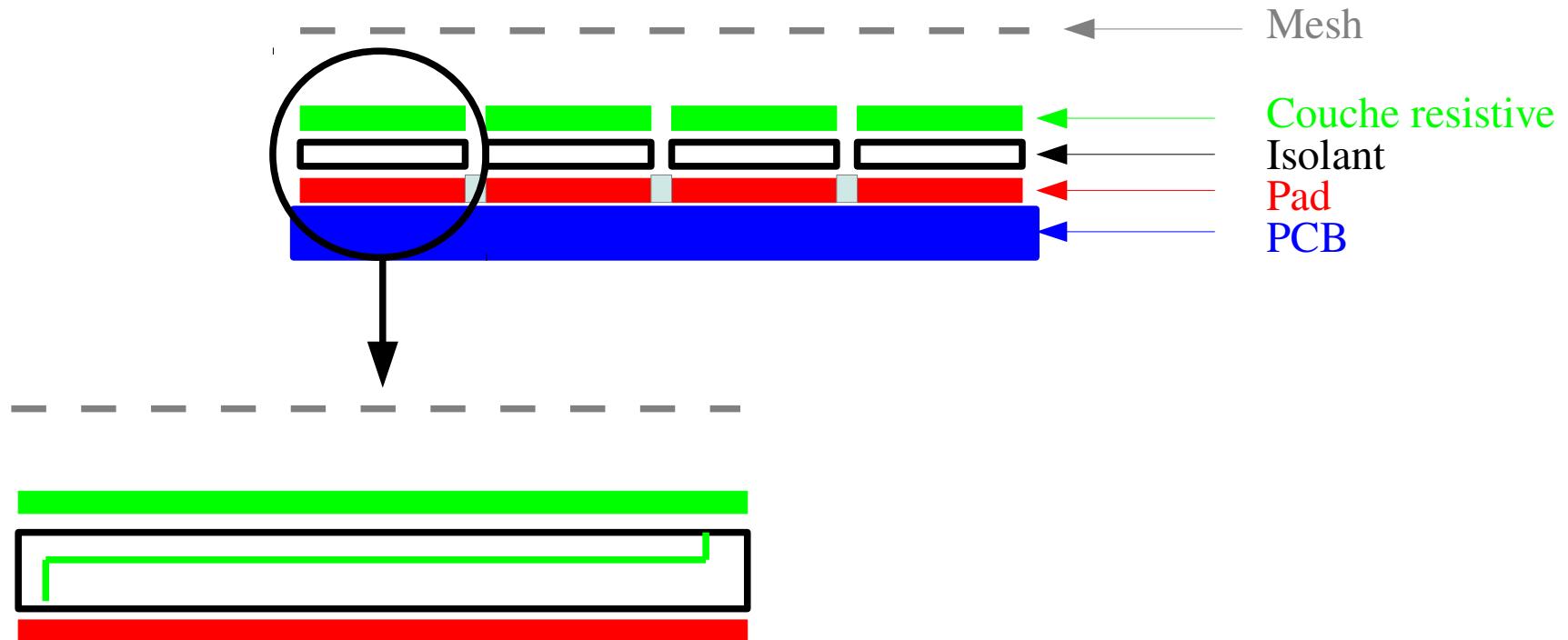


Pb : percage + metallisation des vias

Creation d'une capacite parasite  $C_{\text{via/pad}}$

Zone metallique (entree du via) dans le champs d'amplification

# Idees de fabrication de prototypes micromegas resistifs (solution #2)



Av : Pas de perçage, ni métallisation des via

Pas de capacité parasite  $C_{\text{via/pad}}$

Pas de zone métallique apparente dans le champs d'amplification

# Prototypes micromegas resistifs

## Solution #1 :Coût estime :

Coût PCB : attente devis Eltos et TechCi

## Solution #2 :Coût estime :

4000 CHF pour 4 pieces 8×8 :

1 planification de la surface de pads  
2 depots de coverlay  
2 serigraphies  
Pose du bulk

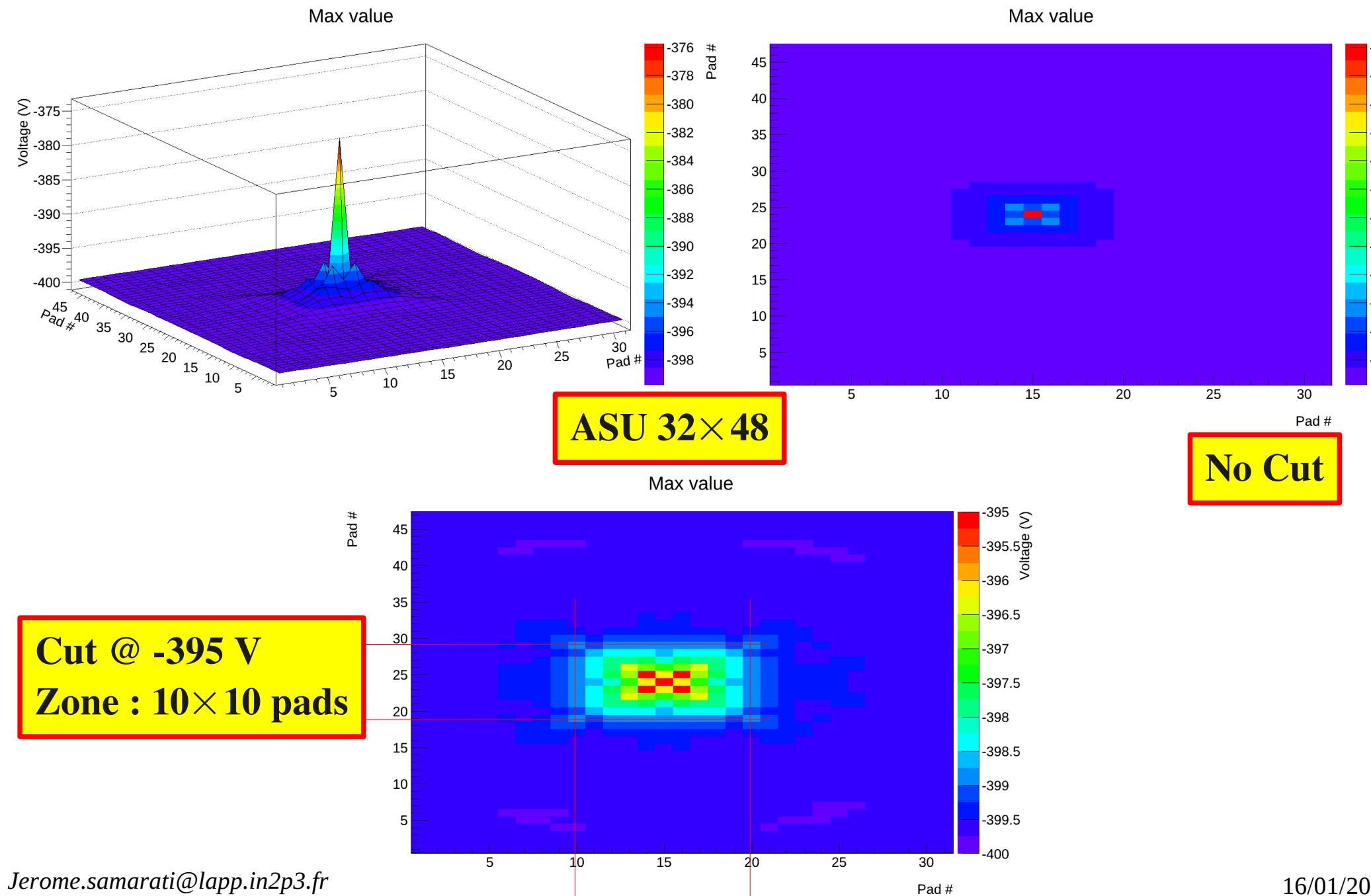
## Temps estime :

4 – 6 semaines pour les 4 pieces (RUI) + fabrication des PCBs

Coût PCB : attente de devis Eltos et TechCi

Coût câblage

# Prototypes micromegas resistifs



# Prototypes micromegas resistifs

